

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成24年3月22日(2012.3.22)

【公開番号】特開2011-198962(P2011-198962A)

【公開日】平成23年10月6日(2011.10.6)

【年通号数】公開・登録公報2011-040

【出願番号】特願2010-63288(P2010-63288)

【国際特許分類】

H 0 1 L 33/30 (2010.01)

【F I】

H 0 1 L 33/00 1 8 4

【手続補正書】

【提出日】平成24年2月6日(2012.2.6)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 1】

第 1 の基板、半導体層及び第 1 の金属層を有する第 1 の積層体と、第 2 の基板及び第 2 の金属層を有する第 2 の積層体と、を貼り合わせる半導体発光素子の製造方法であって、前記第 1 の積層体の劈開方向と前記第 2 の積層体の劈開方向とをずらし、前記第 1 の金属層と前記第 2 の金属層とを接触させて重ね合わせる工程と、前記第 1 の積層体と前記第 2 の積層体との間に加重を加えた状態で昇温し、前記第 1 の積層体と前記第 2 の積層体とを貼り合わせる工程と、
を備え、
前記第 1 の積層体の劈開方向と、第 2 の積層体の劈開方向と、の間のずれは、 1° 以上 10° 以下であることを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0006

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0006】

本発明の一態様によれば、第 1 の基板、半導体層及び第 1 の金属層を有する第 1 の積層体と、第 2 の基板及び第 2 の金属層を有する第 2 の積層体と、を貼り合わせる半導体発光素子の製造方法であって、前記第 1 の積層体の劈開方向と前記第 2 の積層体の劈開方向とをずらし、前記第 1 の金属層と前記第 2 の金属層とを接触させて重ね合わせる工程と、前記第 1 の基板と前記第 2 の基板との間に加重を加えた状態で昇温し、前記第 1 の積層体と前記第 2 の積層体とを貼り合わせる工程と、を備え、前記第 1 の積層体の劈開方向と、第 2 の積層体の劈開方向と、の間のずれは、 1° 以上 10° 以下であることを特徴とする半導体発光素子の製造方法が提供される。